

## 群聯全面轉型 AI 賦能者

### 構築 Phison Pascari aiDAPTIV™ 生態系

全球 NAND 控制晶片與 NAND 儲存解決方案領導廠商 Phison Electronics (群聯電子, 8299.TT) 於 COMPUTEX 2026 正式揭示企業轉型新方向, 宣布以「AI 賦能者 (AI Enabler)」為核心主軸, 從傳統儲存技術領導者, 進一步擴展為涵蓋 AI 基礎架構、邊緣 AI 運算與 AI 軟體平台的全方位 AI 解決方案供應商。

今年展會中, 群聯聚焦於 AI 時代下企業與終端市場面臨的實際挑戰, 包括 AI 模型部署成本過高、GPU 與記憶體資源不足、資料隱私風險, 以及 AI 工作負載對儲存頻寬與能耗帶來的壓力, 並提出完整的 AI 儲存與運算架構解決方案。



聚焦 AI 與高速儲存市場四大核心技術方向：

#### 一、打造企業級 AI、主權 AI 與 Agentic AI 平台

面對大型 AI 模型快速成長所帶來的 GPU、HBM 與儲存頻寬壓力, 群聯於 COMPUTEX 2026 展示完整 AI 基礎架構與本地 AI 解決方案, 協助企業以更低成本、更高資料自主權建置 AI 環境。

- **Phison AI Data Platform**

群聯推出整合式 AI Data Platform, 涵蓋 AI 基礎硬體、資源調度、AI 軟體模組與

應用服務，可協助企業快速部署並擴充本地 AI 環境。

- **Phison HCI 超融合架構軟體**

群聯同步展示自研 HCI (Hyper-Converged Infrastructure) 平台，可進行 AI 工作負載調度、GPU/XPU 資源整合與叢集管理，協助企業整合既有與新世代 AI 基礎架構。

- **Pascari aiDAPTIV™ 技術**

群聯獨家 aiDAPTIV™ 技術，透過將 NAND Flash 作為 AI 記憶體延伸層，大幅降低 AI 對昂貴 DRAM 與 HBM 的依賴，提升 AI 訓練與推論部署彈性。再者，透過 aiDAPTIV™ 動態記憶體架構，整合 GPU VRAM、系統 DRAM 與 Flash Storage，aiDAPTIV™ 可大幅提升系統有效記憶體容量，讓大型 AI Agent 能於本地端硬體上運行。

- **Phison Pascari AI20EH AI PC 極速推論解決方案**

群聯於 COMPUTEX 2026 展示 Pascari AI20EH「AI PC 極速推論解決方案」，並榮獲 COMPUTEX Best Choice Award (BCA) 類別獎。AI20EH 透過群聯獨家 aiDAPTIV™ 技術，將 NAND Flash 作為 AI KV Cache 使用，使 SSD 從儲存裝置進化為 AI 推論加速引擎，可有效降低 DRAM 需求與地端 AI 部署成本。根據群聯測試數據，在相同 AI PC 硬體規格下，Pascari AI20EH 最高可提升 AI 模型推論速度達 102 倍、降低 67% 記憶體使用量，並協助企業降低最高 53% 地端 AI 部署成本。

- **Phison Hybrid Router for OpenClaw**

群聯現場展示與 Intel 深度合作的 Hybrid Router 架構，結合搭載 Intel Core Ultra 處理器的 AI PC 平台與 aiDAPTIV™ 技術，提升本地 Agentic AI 的多任務規劃與工具調用能力，同時兼顧低延遲與資料隱私。

- **UFS 4.1 (PS8363) AI 行動平台方案**

群聯同步展示搭配 MediaTek Dimensity 9500 平台與 aiDAPTIV™ 的 Hybrid UFS 4.1 解決方案，展現行動裝置端 AI (On-device AI) 應用能力，強化 AI 手機與邊緣 AI 裝置的即時推論效能。

## 二、全面布局 AI 資料中心與企業級高速儲存

隨著 AI 訓練與推論帶動資料量高速成長，群聯展示完整 Pascari 企業級 SSD 產品線，涵蓋高容量、高耐用度與高密度 AI 資料中心應用。

- **Pascari D206V**

採 U.2/E1.L/E3.L/E3.S 規格，容量最高達 245.76TB，支援 PCIe Gen5、NVMe 2.0、14GB/s 讀取速度，並具備 Dual-port、Power Loss Protection、AES 加密與 TCG Opal 2.0 等企業級功能，可有效降低 AI 資料中心空間與營運成本。此外，Pascari D206V 也很榮幸的獲頒 Computex BCA (Best Choice Award) 金獎，彰顯群聯在超高容量企業級儲存領域的創新突破。

- **Pascari X202Z**

提供最高 60 DWPD 高耐用度，適用高寫入 AI 工作負載，支援 U.2 與 E1.L 規格。

- **Pascari B200P**  
專為伺服器 Boot Drive 設計，採 M.2 2280 規格，容量最高 7.68TB。
- **Pascari D250P**  
採 E1.S 規格，並展示 Liquid-Cooling Ready 液冷概念設計，對應高密度 AI 資料中心需求。
- **次世代 PCIe Gen6 控制晶片**  
群聯亦搶先展示新一代 PCIe Gen6 SSD 控制晶片 X3，布局下一世代高速 AI 儲存市場。

### 三、推動輕薄筆電與高速行動儲存市場

除 AI 基礎架構外，群聯亦積極布局輕薄筆電與高速行動儲存市場，聚焦低功耗、高效能與輕薄化設計需求。

- **E37T PCIe Gen5 DRAM-less SSD**  
群聯推出 E37T PCIe Gen5 DRAM-less SSD，容量最高可達 8TB，讀寫速度最高可達 14.9GB/s，兼具高速傳輸、低功耗與優異能效，適合輕薄筆電平台。E37T 也獲頒測評網站 [Tweaktown](https://www.tweaktown.com) 評比為 “the best consumer SSD ever made”。
- **UFS 5.0 (PS8365)**  
群聯展示新一代 UFS 5.0 控制晶片 PS8365，傳輸速度最高可達 10GB/s，滿足未來 AI 手機、高速行動裝置與邊緣 AI 系統需求。
- **PS5963 Bridge IC**  
群聯同步展示業界首創 PCIe-to-UFS 3.1 解決方案 PS5963 Bridge IC，搭配 PS8329 UFS 3.1 解決方案，採用 M.2 2230 規格，可應用於主流輕薄筆電市場，兼顧硬體空間設計及成本效益。

### 四、高速傳輸與 PCIe 6.0 訊號完整性技術

隨著 PCIe 6.0 導入 PAM4 訊號技術，高速傳輸的訊號完整性與除錯難度大幅提升。

- **PS7261 PCIe 6.0 Retimer**  
群聯展示 16-Lane PCIe 6.0 Retimer，支援即時遙測分析 (Telemetry)、PAM4 高速訊號眼圖 (Eye Diagram) 視覺化，以及 LTSSM (Link Training and Status State Machine，鏈路訓練與狀態管理機制) 監控功能，可協助研發工程師快速分析 PCIe 6.0 高速傳輸過程中的訊號品質、鏈路穩定性與系統連線狀態。
- **PS7161 Linear Redriver**  
群聯並與 Molex 合作展示整合 PS7161 的 Active Copper Cable，提升高速傳輸距離與穩定性。

群聯電子執行長 潘健成 表示：「AI 時代的競爭力，已不再只是算力的競爭，而是資料存取效率與系統架構整合能力的競爭。隨著全球資料量高速成長，傳統儲存架構已難以滿足現代 AI 訓練與推論需求。群聯近年積極從 SSD 控制晶片技術，延伸至 AI Cache、Computational

Storage 與 AI 平台架構領域，希望透過軟硬體整合，大幅降低企業建置主權 AI 與本地 AI 的門檻與成本。」

群聯 Computex Media Kit: <https://www.phison.com/media-kits/computex-2026>

群聯電子誠摯邀請全球媒體、產業夥伴與客戶，於 COMPUTEX 2026 展覽期間蒞臨群聯展位，親身體驗群聯在 AI 儲存、AI 基礎架構與邊緣 AI 領域的最新技術成果。

展覽日期：2026 年 6 月 2 日至 6 月 5 日

展覽地點：Taipei Nangang Exhibition Center（台北南港展覽館）

群聯展位：M0411a（1 館 4 樓）

**[群聯公告暨新聞稿訂閱]**

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

**[關於群聯的關鍵數字]**

- 超過 25 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 5000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期超越千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA、美光 Micron、SanDisk、三星、SK Hynix、YMTC 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 80%營收貢獻度來自於『高附加價值』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

**[關於群聯電子]**

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期深耕於 NAND 快閃記憶體控制晶片領域，為全球領先的 NAND 控制晶片與儲存解決方案供應商。隨著產業演進，群聯已由傳統控制晶片設計公司，成功轉型為結合 AI 運算與儲存技術的整合型平台服務商，專注於高附加價值與客製化市場。群聯憑藉深厚的韌體演算法、控制晶片設計與系統整合能力，提供從 IP 授權、晶片設計、系統架構、到整機解決方案的一站式服務，並廣泛應用於資料中心、AI 運算、企業級儲存、工業電腦與嵌入式系統等領域。透過與全球 NAND 原廠及策略夥伴的緊密合作，群聯致力於協助客戶加速產品導入 (Design-in)，打造具備高效能、高可靠性與差異化競爭優勢的儲存與 AI 應用解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更好地了解群聯電子。

**群聯電子發言人**

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: [antonioyu@phison.com](mailto:antonioyu@phison.com)

**群聯電子代理發言人**

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: [kuoting\\_lu@phison.com](mailto:kuoting_lu@phison.com)

**[預測性陳述聲明]**

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。